



慧荣科技亮相 FMS 2026, 展示面向 Agentic AI 应用的新一代存储方案

August 5, 2026

全球 NAND 闪存主控芯片领导厂商慧荣科技(NasdaqGS: SIMO)正在加州 Santa Clara 举办的 2026 年未来存储与内存大会(Future of Memory and Storage, 缩写 FMS)上, 于 #315 号展位全面展示其面向 AI 工厂、边缘 AI 和物理 AI 的最新存储创新成果。



随着 AI 从大语言模型训练迈向 Agentic AI 阶段, 实时推理对快速、可预测的数据访问需求日益迫切。KV Cache 和 Agentic AI 等新兴应用场景对存储提出了更高要求——在维持低延迟和稳定性能的同时, 必须最大化数据加速能力。为此, 慧荣科技携五大产品线亮相, 全面覆盖三大 AI 领域(企业基础设施、边缘计算、嵌入式设备及汽车平台)中不断演进的存储需求:

面向 AI 工厂存储应用的数据中心级主控芯片

- SM8366 MonTitan® SSD 参考设计套件, 专为 KV Cache 卸载与 Agentic AI 基础设施打造。MonTitan 企业级 SSD 开发平台基于 SM8366 PCIe Gen5 主控芯片, 兼容 U.2、E3.S 和 E3.L 等多种外形规格, 同时支持 TLC 和 QLC NAND 闪存。容量方面, 使用 TLC NAND 可达 32TB 和 64TB, 换用 QLC NAND 更能扩展至 256TB, 可灵活部署于各类 AI 基础设施架构。该平台支持高达 28% 的可配置预留空间, 最高可实现每日 3 次全盘写入(DWPD)的耐久度。得益于慧荣科技已获专利的 PerformaShape™ QoS引擎, 平台能够为 AI 推理和 KV Cache 卸载提供超低延迟和可预期的服务质量(QoS), 为下一代 Agentic AI 基础设施的加速部署提供有力支撑。
- SM8466: PCIe Gen6 企业级 SSD 主控芯片, 拥有 28 GB/s 的顺序吞吐量和 700 万次随机 IOPS, 支持超过 512TB 的企业级 SSD 容量, 面向下一代 AI 基础设施和海量数据 AI 工作负载。

- SM8388:PCIe Gen5 企业级 SSD 主控芯片, 采用单主控芯片架构并针对大容量企业级 SSD 优化, 为超大规模 AI 基础设施和大规模 AI 推理部署提供高性价比的存储方案。

面向 AI 工厂应用的企业级启动盘方案

- 企业级 PCIe NVMe SSD 启动盘方案:针对企业服务器、DPU、网络设备和 AI 存储节点优化的高可靠、低延迟启动存储方案, 具备企业级耐久度、安全性和长期运行稳定性。
- SM8008:PCIe Gen5 企业级主控芯片, 符合 OCP 启动盘规范, 在不足 5 W 的功耗下即可实现 14 GB/s 的性能, 专为数据中心启动盘和高能效企业服务器机架而设计。

面向 AI PC 与边缘 AI 应用的边缘 SSD 主控芯片

- SM2524XT:PCIe Gen5 DRAM-less 架构 SSD 主控芯片, 顺序读取高达 14.5 GB/s, 随机性能达 280 万次 IOPS, 专为 AI 推理和 KV Cache 卸载优化。
- SM2508:PCIe Gen5 SSD 主控芯片, 读写性能均达 14.5 GB/s, 随机性能达 250 万次 IOPS, 适用于高性能 AI PC 和边缘 AI 平台。

面向移动设备与边缘 AI 应用的嵌入式 UFS 及 eMMC 主控芯片

- SM2755:UFS 4.1 主控芯片, 为 AI 智能手机、可穿戴设备和智能边缘设备带来高带宽、超低延迟与卓越能效。
- SM2738:eMMC 5.1 主控芯片, 针对 AI 嵌入式、工业和智能家居应用优化, 兼顾高可靠性与低功耗。

面向汽车与物理 AI 应用的 Ferri 方案

慧荣科技还在展会现场展示了专为汽车和物理 AI 应用打造的 Ferri 存储方案。该方案为高可靠性嵌入式存储, 全面符合 AEC-Q100 Grade 2/3、ISO 26262、ISO 21434 和 ASPICE 等行业标准。Ferri 系列专为软件定义汽车、自主系统、无人机、机器人及关键任务边缘计算而设计, 在功能安全、网络安全和长期可靠性方面均有出色表现。

FMS 2026 已正式开幕, 展会为期三天。欢迎各界人士莅临 #315 号展位, 亲身体验慧荣科技面向 AI 工厂、边缘 AI 和物理 AI 应用的全场景 AI 存储方案。展会期间, 公司代表还将出席 FMS 主题演讲及各技术论坛, 分享最新的 AI 存储创新成果。了解更多信息, 请访问: <https://www.siliconmotion.com/events/2026FMS/>

关于慧荣科技

慧荣科技(Silicon Motion Technology Corporation, NasdaqGS: SIMO)是全球固态存储设备NAND Flash主控芯片领域的创新厂商。公司为服务器、个人电脑及其他边缘设备提供的SSD主控芯片出货量居世界前列, 同时也是智能手机、物联网产品及汽车应用中所用eMMC和UFS嵌入式存储主控芯片的主要供应商。

慧荣科技为企业级SSD、边缘SSD、嵌入式UFS及eMMC提供定制化高性能主控芯片方案, 以及企业级启动盘和汽车级Ferri存储方案。其主控芯片与存储解决方案专为驱动全球最先进的AI基础设施、边缘AI及物理AI而设计, 融合了高性能、低功耗与久经验证的可靠性。